

# bga芯片植球返修,芯片拆解,IC清洗,QFP整脚,QFN除锡脱锡

产品名称	bga芯片植球返修,芯片拆解,IC清洗,QFP整脚,QFN除锡脱锡
公司名称	深圳市维佳芯片返修科技有限公司
价格	.15/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区观澜街道大和社区东掩山怡力科技园厂房A栋503东
联系电话	15989499421 15989499421

## 产品详情

### 【公司介绍】

深圳市维佳芯片返修科技有限公司成立于2010年。现厂房面积700多平方米，全体成员60多人，是一家正规注册的芯片返修公司。

我司从事芯片返修。主营业务CMOS Sensor返修（COB/CSP/PLCC等封装均可返修），BGA摄像头芯片返修（OV、SP、GC、BYD、HY等），PCBA拆板返修（PCBA拆解、换料、IC镀脚整脚、磨字盖面、QFN清洗、IC翻新刻字、编带、DDR植球等）一条龙服务。

现已启动自动化机械植球，良率及效率更高。并配备了标准百级无尘室，无尘工作台。为您企业带来更高的效益。降低运营成本，实现利益巨大化。

### 【返修加工服务】

- 1、CMOS Sensor返修（COB/CSP/PLCC等封装均可返修），摄像头芯片植球、测试、划伤抛光修复等。
- 2、PCBA拆板返修：PCBA拆解、换料、各类BGA芯片植球、QFP整脚、QFN除锡清洗、各类IC清洗、编带等。
- 3、散片处理：主控/DDR/EMMC等BGA植球返修、Flash脱锡整脚、QFN芯片除锡清洗、编带、各类IC翻新加工。

### 【返修加工流程】

- 1、发样品图片，我司确认IC类型和封装，确认拆卸/处理需求。

- 2、 我司根据贵司的样品图片和加工需求，做报价单。
- 3、 贵司来料，我司收到货后核对数量，排交期，上线。
- 4、 我司如期做完，处理好的IC发货给贵司并结算货款。

#### 【返修加工收费】

根据不同芯片的封装类型、尺寸、引脚/锡球数量和密度的不同报价。返修加工的难度越高、效率越低的芯片，价格会相对越高；返修难度低、效率高的芯片，价格会越低。

#### 【返修加工优势】

我司自2010年成立以来，已经专注芯片拆解返修10年。目前合作的芯片厂商数家，并首家获得芯片封装厂授权返修。合作的CCM厂商百余家，各类电子厂商（安防领域、行车领域、无人机领域等）百余家。我们有的返修方案、成熟的工艺技术、完善的流程管理、严格的品质管控！能够高良率、高效率、高产能的为您提供一站式服务！